

レーザー協会 第187回研究会

「国内外におけるレーザー加工技術の今」

【日時】2020年5月20日(水) 14:30~17:00

【会場】中央大学 後楽園キャンパス

※建物・部屋は未定

〒112-8551 東京都文京区春日 1-13-27

<https://www.chuo-u.ac.jp/access/kourakuen/>

<https://www.chuo-u.ac.jp/campusmap/kourakuen/>



14:30~14:35 **開会挨拶**

レーザー協会会長

14:35~15:15 **講演1** 「フェムト秒レーザー3次元加工によるマイクロ・ナノデバイスの作製」

理化学研究所 杉岡 幸次 氏

15:15~15:55 **講演2** 「Digital Manufacturing の中で生きる Laser Processing

～ドイツにおける Laser processing の動向も含めて～」

東北大学 水谷 正義 氏

15:55~16:15 **休憩**

16:15~16:55 **講演3** 「高精度レーザー加工と計測を実現するためのころがり機械要素技術と機械設計について」

日本精工株式会社 新井 覚 氏

16:55~17:00 **閉会挨拶**

【参加費】 会員:無料, 非会員:4,000円 (当日お支払いください)

【申し込み先】 会員の方は別途お送りする案内にある返信票に記入のうえレーザー協会事務局へメールでご送付ください。非会員の方はレーザー協会ウェブページ <http://jslt.jp/> の申し込みフォームよりお申し込みください。

【問合せ先】 レーザー協会事務局 laser@mech.saitama-u.ac.jp